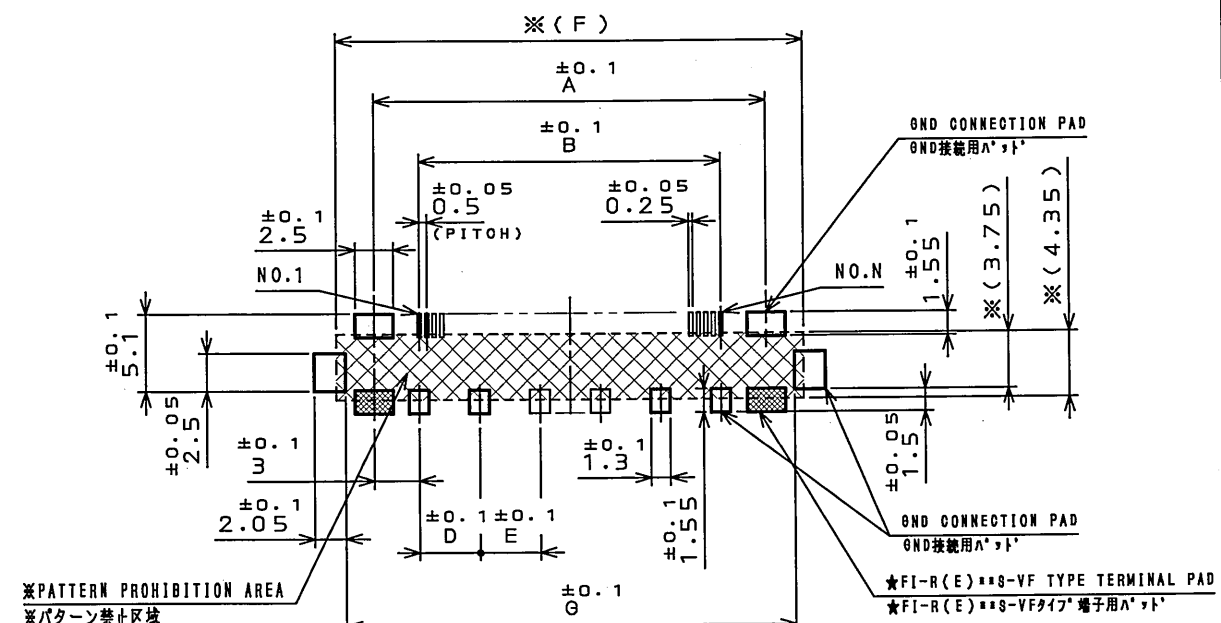
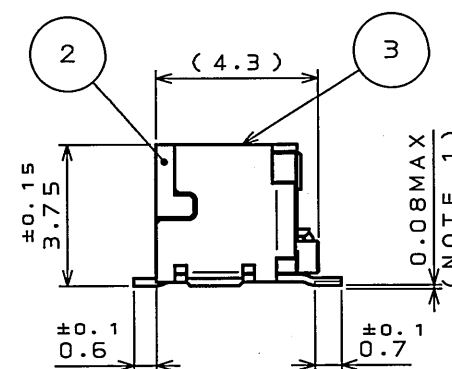




APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法 (参考)



MAX0.75mm

(15.75)

FI-RE=HL

3.75

MATED CONDITION (REF.)

嵌合状態図(参考)

CONTACT AREA 接触部	SOLDERING AREA 端子部
GOLD OVER NICKEL NiAu	TIN OVER NICKEL NiSn

DEMENSION NO.OF CONTACTS(N)	A	B	C	D	E	F	G	H
2 1	16	10	20.35	3	—	20.95	19.75	22.85
3 1	21	15	25.35	4	—	25.95	24.75	27.85
4 1	26	20	30.35	4	4	30.95	29.75	32.85
5 1	31	25	35.35	5	5	35.95	34.75	37.85

注1. 端子及び、シェルのホールドダウンの相互の
パラツキは0.08以内とする。

3	SHELL シェル	1	STAINLESS STEEL ステンレス	TIN PLATING Snメッキ	
2	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱性プラスチック		UL94 V-0
1	CONTACT コンタクト	TABLE 2	COPPER ALLOY 銅合金	TABLE 1	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 15.Mar.2005		尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) FI-R
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) FI-RE**S-HF (SHIELD TYPE)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.  図面番号 (DRAWING NO.) SJ102934
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.	K.HISAMATSU		
. ±0.8	X° ±	査閲 APPD.	M.SUZUKI		
.X ±0.4	X°X' ±	承認 APPD.	K.HISATOMI		
.XX ±0.1				質量 (MASS)	
.XXX ±				